

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年5月27日(27.05.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/100538 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 283/04 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) G03F 7/037 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01) H05K 3/28 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/041824
- (22) 国際出願日: 2020年11月10日(10.11.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-207632 2019年11月18日(18.11.2019) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 河野友孝 (KAWANO, Tomotaka); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
松元亜紀子 (MATSUMOTO, Akiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

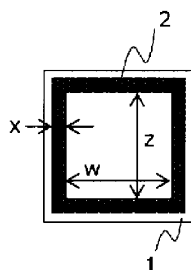
式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 金森大典 (KANAMORI, Daisuke); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 桂田悠基 (KATSURADA, Yuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE RESIN SHEET, HOLLOW STRUCTURE, CURED MATERIAL, HOLLOW STRUCTURE PRODUCTION METHOD, ELECTRONIC COMPONENT, AND ELASTIC WAVE FILTER

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、感光性樹脂シート、中空構造体、硬化物、中空構造体の製造方法、電子部品、及び弾性波フィルター

【図1A】



(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a resin composition that is excellent in pattern-processability and pressure resistance, from which a highly reliable insulating film can be formed, and is applicable to the use for a substrate to which a high elastic modulus and a high resolution are required. A photosensitive resin composition contains a polymer (A), a glass filler (B), a photopolymerizable compound (C), a photoinitiator (D) and a thermal crosslinker (E), the glass filler (B) containing at least two selected from the group consisting of silicon oxide, aluminum oxide, and boron oxide, and the glass filler (B) further containing a rare earth oxide.

(57) 要約: パターン加工性および耐圧性に優れ、且つ信頼性の高い絶縁膜を形成することができ、高弾性率および高解像度を要求される基板用途などに適用可能な樹脂組成物を提供することを課題とするものであり、(A) ポリマー、(B) ガラスフィラー、(C) 光重合性化合物、(D) 光重合開始剤、及び(E) 熱架橋剤を含有する感光性樹脂組成物であって、前記(B) ガラスフィラーは、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、及び酸化ホウ素からなる群から選ばれる少なくとも二種を含有し、さらに希土類酸化物を含有する、感光性樹脂組成物。

[続葉有]

WO 2021/100538 A1

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）